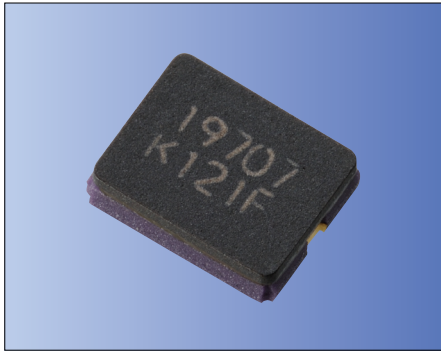




表面贴装型 CX3225GA (车载应用)

3.2×2.5mm



■特点

- 车载应用晶体谐振器
- 提高电极焊接部分的耐久性
- 小型、薄型 厚度0.85mm
- 陶瓷封装
- 小型薄型以及优异的耐冲击性
- 可对应回流焊
- 热循环焊接强度: -40~125°C、3000次

■用途

- 发动机操纵机构
- 轮胎压力监测系统(TPMS)
- 高速车载网络

■型号表示方法

CX3225GA 16000 D0 P T V □□  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称  
③负载容量

②频率  
④频率容差  
(常温偏差)

D0 8 pF

P ±50×10<sup>-6</sup>

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

TV -40 ~ +150 °C ±150×10<sup>-6</sup>

⑦个别规格

包装方式(载带包装 3000个/卷盘)

AEC-Q200 RoHS指令对应产品

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f <sub>nom</sub>	8 / 12 / 16 / 20 / 25 / 40	MHz	其他频率, 敬请咨询。
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f <sub>tol</sub>	±50	×10 <sup>-6</sup>	25 °C ±3 °C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	10μW(200μW max.)	μW	
工作温度范围	T <sub>use</sub>	-40 ~ +150	°C	
储存温度范围	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +150	°C	
频率温度特性	f <sub>tem</sub>	±150	×10 <sup>-6</sup>	对于25°C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

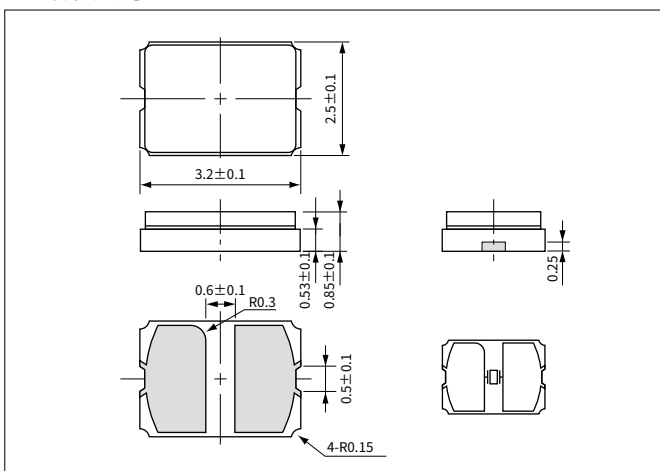
■Table1 串联电阻 其他频率, 敬请咨询。

频率	串联电阻
8MHz	500Ω max.
12MHz	200Ω max.
20MHz	100Ω max.

晶体谐振器

■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)

